

Investor Relations 1Q.2018

Your Most Trustworthy



유의 사항

Disclaimer

본 자료는 한국채택국제회계기준 연결실적에 대한 경영실적 및 재무성과를 바탕으로 작성되었습니다.

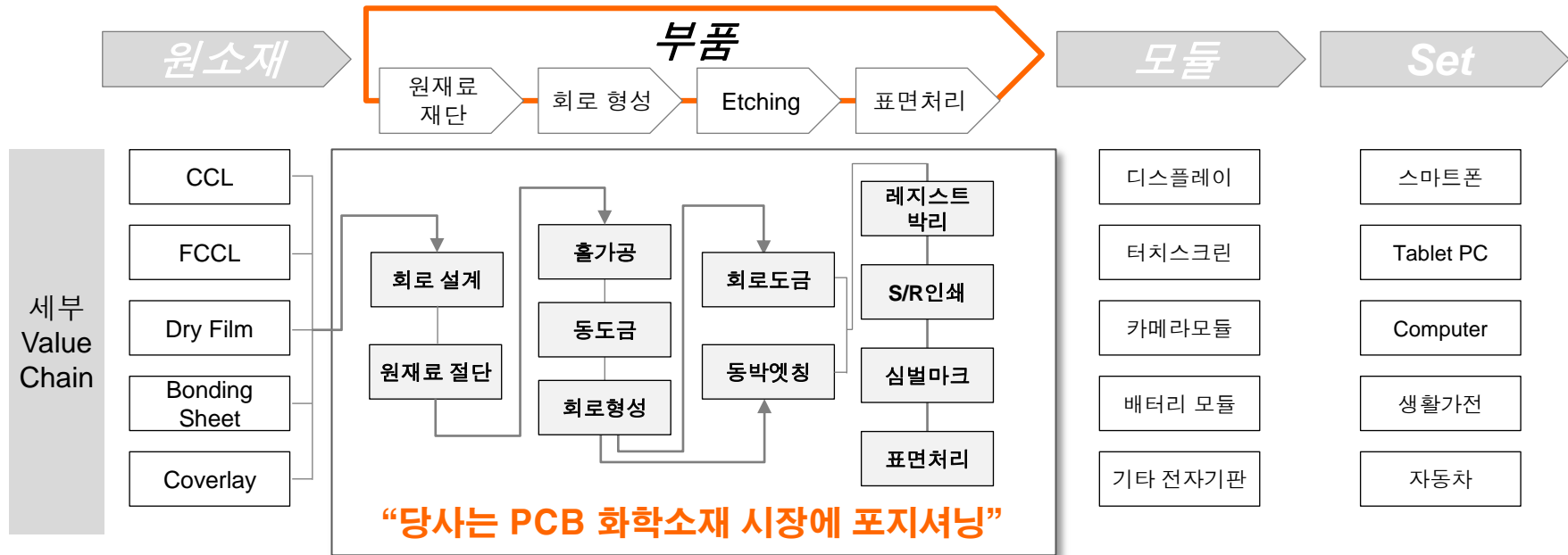
또한 본 자료는 미래에 대한 "예측정보"를 포함하고 있으며, 이러한 "예측정보"는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 불확실성으로 인하여, 실제 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있습니다.

- 국내외 국가정책변경에 따른 세율 변동 (FTA, 관세, 법인세 등)
- 환율 및 이자 변동을 포함한 국내외 금융시장의 동향
- 주요 매출시장의 환경의 예상치 못한 급격한 변화
- 회사내의 전략적인 의사결정

이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 "예측정보"에 기재되거나 암시된 내용과는 중대한 차이가 있을 수 있습니다.

와이엠티는 전자소재 산업에서 반드시 필요한 **화학소재를 직접 개발 / 제조 / 납품하는 회사**로써, 모바일 뿐만 아니라 전기자동차, 웨어러블 디바이스, 바이오 센서 등에서도 그 가치를 인정받고 있습니다.

- ✓ 주요 표면처리 분야 : 무전해금도금 프로세스 [Soft ENIG / ENIG / ENEPIG], 무전해 화학동, 프로세스 케미컬
- ✓ 주요 고객사 : 영풍전자, 삼성전기, 인터플렉스, 비에이치, Foxconn 등



YMT Co.,Ltd.

- 회사명 • 와이엠티(주)
- 설립일 • 1999. 02. 11
- 대표자 • 전성욱 (표면처리 기술사)
- 종업원 • 본사 147 (한국 : 137명 / 대만 10명)
- 소재지 • 인천광역시 남동구 남동동로 153번길 30
- 자본금 • 3,703백만원
- 주요제품
 - PCB 화학소재
 - 전자소재 분야
 - 표면처리외주도금[YPT]
- 주요시장
 - 모바일용 기판 및 모듈
 - 무선충전기용 모듈
 - Auto mobile 용 전장 부품
 - 바이오 센서 등

계열사 현황

YMT Shenzhen

- PCB 화학소재 중국 판매 법인
- 심천에 위치하고 있으며, 중국 및 대만계열 고객사 확보

YMT Taiwan Branch

- PCB 화학소재 대만 판매지사
- Taoyuan 위치, 대만에 위치한 PCB 본사 영업

YMT Vina

- PCB 화학소재 판매 및 제조법인
- 박닌,빈푹성 위치, 도금 외주사업 시행 예정.3Q.2018

YPT

- 금도금 및 동도금 표면처리 외주 법인
- 안산에 위치, 한국 No.1 표면처리 외주 회사

Beyond Solution

- PCB용 장비 제조 및 판매

		주요 제품군	Function	주요 고객사	매출비중(1Q.18)
Chemical	Finish Plating [금도금약품]	<ul style="list-style-type: none"> FPCB 금도금 RFPCB 금도금 카메라모듈 도금 	<ul style="list-style-type: none"> PCB 표면 실장부위 산화방지 SMT 신뢰성 향상 (모듈연결) 	<ul style="list-style-type: none"> ZDT, Career 삼성전기, 비에이치, 영풍전자 등 	<ul style="list-style-type: none"> 40.7%
	Copper Plating [동도금약품]	<ul style="list-style-type: none"> 전기동 무전해 화학동 	<ul style="list-style-type: none"> 적층회로 연결 동의 두께 조절로 회로 hole 외벽 도금 및 Via-fill 도금 	<ul style="list-style-type: none"> 삼성전기, 비에이치, 영풍전자, 인터플렉스 등 	<ul style="list-style-type: none"> 19.5%
	Process[공정약품]	<ul style="list-style-type: none"> 박리제 에칭제 세정제 등 	<ul style="list-style-type: none"> DES 공정약품(회로형성) PCB 전반 공정에 걸친 약품 보유 Display, 반도체 약품 등 	<ul style="list-style-type: none"> 대덕GDS, 심텍 등 	<ul style="list-style-type: none"> 10.1%
Plating Outsourcing	Gold Plating [금도금외주]	<ul style="list-style-type: none"> FPCB / RFPCB 외주 도금 카메라모듈 도금 	<ul style="list-style-type: none"> RFPCB / 카메라모듈 외주 금도금 (고객사 공정 일부 대체) 	<ul style="list-style-type: none"> 대덕전자, 엘지이노텍 등 	<ul style="list-style-type: none"> 22.2%
	Copper Plating [동도금외주]	<ul style="list-style-type: none"> 무전해 화학동 Via-Fill 도금 	<ul style="list-style-type: none"> 하이엔드 동도금, VIAFILL 도금 전공정 외주 	<ul style="list-style-type: none"> 영풍전자, 비에이치, TLB 등 	
Materials/Facility	Electronic Materials [전자재료]	<ul style="list-style-type: none"> Copper foil RTR 도금 CCL 등 	<ul style="list-style-type: none"> 극동박(Ultra thin copper foil)을 이용한 차폐재, SLP용 동박 등 도금 기술을 이용한 전자 소재 	<ul style="list-style-type: none"> Global 화학/소재 회사 	<ul style="list-style-type: none"> -
	Facility&상품	<ul style="list-style-type: none"> 자동공급기 화학동 장비 유지보수 등 	<ul style="list-style-type: none"> 고객사 양산 라인 금도금, 화학동도금 자동공급기 도금라인 유지보수,중고설비,제작 	<ul style="list-style-type: none"> PCB 제조사 	<ul style="list-style-type: none"> 7.5%

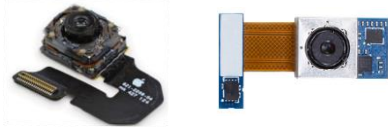
Finish Plating chemical

Soft ENIG Process



- ✓ FPCB / RFPCB 전용 금도금 프로세스
- ✓ 글로벌 M/S 및 기술력 1위
- ✓ 초 미세회로 구현 가능
- ✓ 삼성전자, 애플 제품 탑재

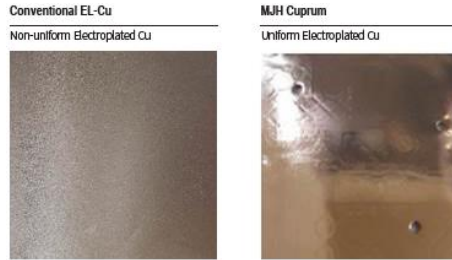
ENEPIG Process



- ✓ 카메라 모듈등에 적합한 미세회로 최종 표면처리
- ✓ 글로벌 Top tier 점유율 확보
- ✓ 원가경쟁력 및 기술경쟁력 확보

Copper plating chemical

Electroless Copper plating



- ✓ RA / HA 동박 전용 화학동도금 프로세스
- ✓ 경쟁사 대비 외관 품질 매우 우수

VFBJ series

- ✓ 모듈의 증가로 PCB가 경박단소화에 따라 고밀적 회로 및 적층에 대한 니즈 증가
- ✓ 이로 인해 고사양 VIAFILL 프로세스 채택 고객사 증대
- ✓ 기존 100% 외산시장에 현재 진입하여 점유율 확대중

Ultra-thin copper foil

Peelable Copper Foil: 1 ~ 2um



- ✓ 알루미늄 캐리어를 이용하여 특허분쟁을 피해 극박개발 성공
- ✓ 현재 유수의 PCB제조사 및 소재회사와 함께 Test 진행 중



[다양한 Application]

- ✓ MSAP, SAP 용 동박
- ✓ EMI 차폐, 방열용 동박
- ✓ FCCL 동박 등

사업 영역
Business area

PCB Market & YMT Business area

		FPCB, RFPCB	HDI	PKG	RIGID
Customer	Domestic	<ul style="list-style-type: none"> • SEMCO • BH Flex • Youngpoong • Interflex 	<ul style="list-style-type: none"> • SEMCO • Daeduck • LG Innoteck • KCC 	<ul style="list-style-type: none"> • SEMCO • Daeduck • LG Innoteck • KCC 	<ul style="list-style-type: none"> • Hyunwoo
	Global	<ul style="list-style-type: none"> • Zhending Technology • Career • Unimicron • Mektron 	<ul style="list-style-type: none"> • AT&S • Zhending Technology • Ibiden 	<ul style="list-style-type: none"> • AT&S • Zhending Technology • Ibiden 	<ul style="list-style-type: none"> • Various
Process Chemical		<ul style="list-style-type: none"> • M/S expansion 	<ul style="list-style-type: none"> • Penetration by SLP chemical in 2018 	<ul style="list-style-type: none"> • Developing 	<ul style="list-style-type: none"> • Globally, Small M/S
Cu Plating	Electroless	<ul style="list-style-type: none"> • 15% ~ 20% in Korea market 	<ul style="list-style-type: none"> • Developing 	<ul style="list-style-type: none"> • 1Q. 2018 start 	<ul style="list-style-type: none"> • Developing
	Electro	<ul style="list-style-type: none"> • Market expansion 	<ul style="list-style-type: none"> • Developing 	<ul style="list-style-type: none"> • Developing 	<ul style="list-style-type: none"> • Developing
Finish Plating	Electroless	<ul style="list-style-type: none"> • Globally, over 50% 	<ul style="list-style-type: none"> • Developing 	<ul style="list-style-type: none"> • Developing 	<ul style="list-style-type: none"> • Globally, Small M/S
	Electro	<ul style="list-style-type: none"> • Developing 	<ul style="list-style-type: none"> • Developing 	<ul style="list-style-type: none"> • Developing 	<ul style="list-style-type: none"> • Developing

ENEPIG 공정 매출 확대

• 스마트폰 카메라 탑재 수 증가

- ✓ 홍채인식/안면인식 등의 이유로 스마트폰 카메라 고사양화 진행
- ✓ 대표적 High-end 스마트폰인 I-phone X의 경우 카메라 6대 적용 (전면 4, 후면 2)
- ✓ 중국 Local 업체인 샤오미, 화웨이, 오포 등의 제조사 또한 전/후면 듀얼 카메라 를 채택
- ✓ 스마트폰 카메라 고사양화에 따라, 카메라 모듈 프로세스인 ENEPIG 화학소재의 매출 확대 전망

동도금 매출 확대 전망

• 하이엔드(FPCB,RFPCB) 동도금 화학소재 성장

- ✓ 특히 회로 세밀화 및 다층 기판[Multi layer]의 적층수가 증가됨에 따라 기존의 화학동 소재가 아닌 High-end 소재에 대한 고객사의 Needs 증가
 - ✓ 이에 따른 18년 FPCB & RFPCB 시장 동도금 점유율은 17년 10~15%, 18년 약 30% 수준으로 전망
- ### • 고부가가치 PKG Substrate 으로의 영역 확대
- ✓ FPCB, RFPCB의 Performance를 바탕으로 고가시장 진출
 - ✓ 외산 점유율이 매우 높은 시장에서 m/s 확대 기대

반도체 화학소재 시장 진출

• Wet Chemical 시장 진출

- ✓ PCB process chemical 대비 고가약품 시장 진출
 - ✓ UBM Etchant, Cu Etchant 개발 완료 및 고객사 Test
 - ✓ 후공정 Bump 업체 target
- ✓ 향후 100% 외산이 점유하고 있는 Wafer 도금 시장 Target!

YPT(Out sourcing plating)

• Via-fill 장비 Set-up

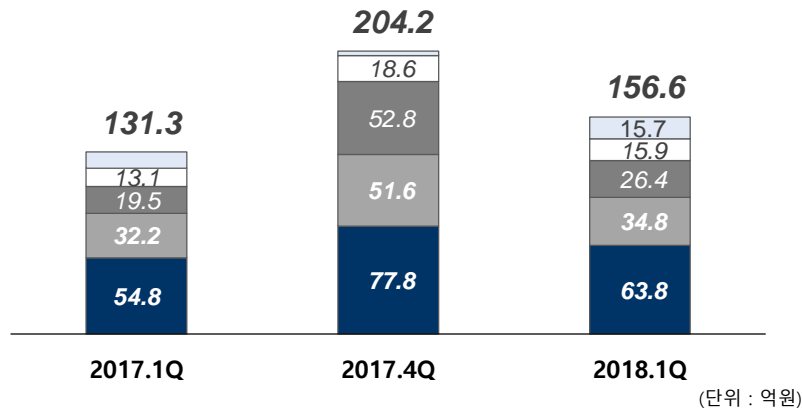
- ✓ RF PCB 등 고사양 PCB 동도금 외주 사업 진출 (Via-Fill 프로세스)
- ✓ 17년 4분기 2 Line Set-up

• 베트남 시장 진출

- ✓ 현재 Job-shop이 없는 베트남 시장 선점을 위해 YPT 공장 건설 진행
- ✓ Major 고객과 협업을 통해 안정적인 시장 진입

사업별 매출액 및 매출

■ 최종표면처리 ■ 기판가공 ■ 동도금 □ Process Chemical □ 기타 Total



	2017.1Q	2017.4Q	2018.1Q
Total	131.3	204.2	156.6
최종표면처리	54.8	77.8	63.8
기판가공	32.2	51.6	34.8
동도금	19.5	52.8	26.4
Process Chemical	13.1	18.6	15.9
기타	11.7	3.4	15.7

1Q.2018 손익계산서

(단위 : 억원)

	1Q.2018	1Q.2017
I. 매출액	156.6	131.3
II. 매출원가	95.7	79.6
III. 매출총이익	60.9	51.8
IV. 영업이익	32.9	28.9
기타수익	1.4	1.4
기타비용	0.9	1.8
금융수익	1.3	0.8
금융비용	4.6	9.7
V. 법인세차감전순이익	30.2	19.6
법인세비용	7.5	4.7
VI. 분기순이익	22.6	14.9
지배기업소유주지분	16.6	11.2
비지배지분	6.0	3.7

END OF DOCUMENT

감사합니다.